技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | | 江苏矽时代材料科技有限公司 | | | 机构代码 | | 91320684055221089X | |
| 区 域 | | | | 海门临江 | 联系人 | 张传勇 | | 电话 | | 15895553976 |
| 行业领域 | | | | 环氧胶黏剂 | | | 产业领域 | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 科学研究和技术  服务业 | | | |
| 经济规模 | | | | 5000万 | | | 人员规模 | | 63人 | |
| **需求信息** | | | | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | □技术研发（关键、核心技术）  ☑产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | **需求名称：导热填料（做到5W/m.K的胶黏剂）** | | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  **需求名称：导热填料（做到5W/m.K的胶黏剂）**  国内外对高导热胶黏剂都有更高的需求，技术上可以为半导体的制造程序节省工序和时间，但是胶黏剂一般能做到4 W/m.K以上的变得很少，凤毛菱角。这主要是由于填料需要优化，达到高的添加形成好的导热网络，同时胶体强度也要保证。  因此，填料的优化与选择变得很关键。  填料必须满足下列技术指标：   1. 添加量必须大于90wt%； 2. 填料表面处理，达到稳定储存；   粒径最好为球形，能够大小粒径进行极配； | | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  我们的产品已经有一部分符合  我们目前已经有相关产品的研发能力，我们并不打算自己合成填料，只是需求这类型的填料来满足我们产品开发的要求。目前我们自己有研发实验室，三维混合机、球磨机、拉力机等等相关检测设备，可以基本检测产品的性能。 | | | | | | | |
| 产学研合作需求 | 需求  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  如果有现成的产品，我们更愿意购买产品尝试。 | | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 ☑委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 ☑科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ☑是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ☑是  □否 | | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ☑是  □否 | | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ☑否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | | |